

Dk 3.31 Df 0.0023
@14GHz

Tg(DSC) 200°C

T288(含铜)
>120分钟

MEGTRON7

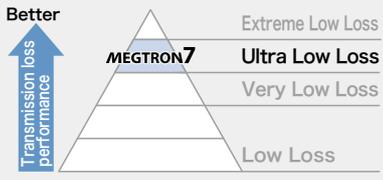
芯板
R-5785(N)* R-5785(GN)* R-5785(GE)

半固化片
R-5680(N)* R-5680(GN)* R-5680(GE)

*低介电常数玻璃布类型

超低传输损耗·高耐热性多层基板材料

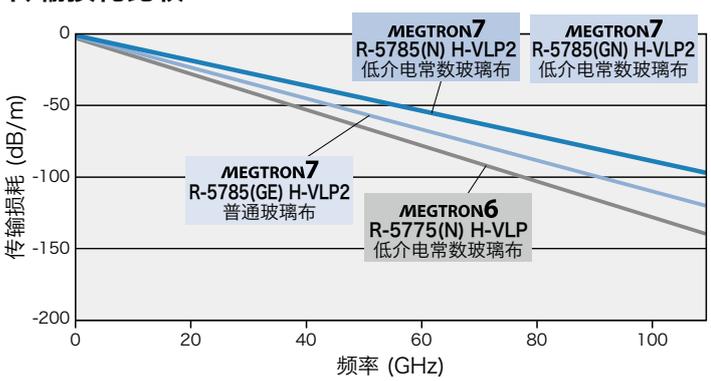
具备超低介电常数 / 介质损耗特性, 适用于高速大容量数据传输类高端服务器和路由产品。支持高多层, 超大尺寸 PCB 产品。



应用
网络/无线通信

ICT 基础设施设备, 超级计算机, 测量仪器, 天线(基站、车载毫米波雷达)等

传输损耗比较



高多层耐热性

结果

孔径	φ0.3mm		
	通孔壁间距离	0.4mm	0.5mm
R-5785(N) 低介电常数玻璃布 / H-VLP2	合格	合格	合格
R-5785(GN) 低介电常数玻璃布 / H-VLP2	合格	合格	合格

条件
260°C回流焊×20次

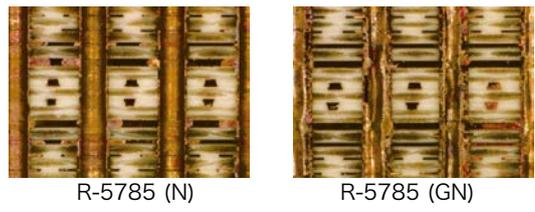
叠构
32层
板厚: 4.5mm



测定方法	2端口 S参数
测定频率	10MHz-110GHz
校正方法	TRL法
阻抗匹配	调整到 50Ω(Zo)

层1: 信号线层
(线宽: 270μm、铜箔厚度: 24μm)

层2: GND平面层
(铜箔厚度: 24μm)



一般特性

项目	试验方法	条件	单位	MEGTRON7 R-5785(N) 低介电常数玻璃布	MEGTRON7 R-5785(GN) 低介电常数玻璃布	MEGTRON7 R-5785(GE) 普通玻璃布
玻璃态转化温度(Tg)	DSC	A	°C	200	200	200
热膨胀系数(Z-轴方向)	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	α1	42	42
				α2	280	280
T288(含铜)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分钟	>120	>120	>120
介电常数(Dk)	平衡型圆盘共振法	C-24/23/50	-	13, 14GHz	3.31 [14GHz]	3.60 [13GHz]
介质损耗因数(Df)				0.0023 [14GHz]	0.0034 [13GHz]	
铜箔剥离强度	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.8 [H-VLP]	0.8 [H-VLP2]	0.8 [H-VLP2]

试验片厚度为0.75mm。
在使用本产品时, 请在我公司网站上确认注意事项。

上述数据为本公司测量所得的代表值, 非保证值。